

MEIKO REPORT

第49期 第2四半期 株主通信

(2023年4月1日から2023年9月30日)

証券コード：6787

株式会社 メイコー



財務ハイライト

売上高

86,216 百万円

営業利益

4,197 百万円

親会社株主に帰属する四半期純利益

5,223 百万円

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2023年3月31日現在	当第2四半期末 2023年9月30日現在
資産の部		
流動資産	91,905	105,371
固定資産	110,489	125,343
有形固定資産	95,537	110,304
無形固定資産	6,999	6,684
投資その他の資産	7,951	8,353
資産合計	202,394	230,714
負債の部		
流動負債	73,672	88,010
固定負債	44,246	44,709
負債合計	117,919	132,719
純資産の部		
株主資本	59,981	64,329
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	13,700	13,700
利益剰余金	35,568	39,913
自己株式	△2,176	△2,172
その他の包括利益累計額	17,339	26,473
その他有価証券評価差額金	13	58
繰延ヘッジ損益	54	△67
為替換算調整勘定	17,425	26,529
退職給付に係る調整累計額	△154	△47
純資産合計	84,475	97,994
負債純資産合計	202,394	230,714

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2022年4月1日～ 2022年9月30日	当第2四半期(累計) 2023年4月1日～ 2023年9月30日
売上高	81,710	86,216
売上原価	69,189	72,327
売上総利益	12,520	13,889
販売費及び一般管理費	7,879	9,691
営業利益	4,641	4,197
営業外収益	4,595	3,207
営業外費用	495	645
経常利益	8,741	6,760
特別利益	0	41
特別損失	213	56
税金等調整前四半期純利益	8,527	6,745
法人税等	2,156	1,497
四半期純利益	6,371	5,247
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△48	24
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,419	5,223

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2022年4月1日～ 2022年9月30日	当第2四半期(累計) 2023年4月1日～ 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,327	10,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,483	△12,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,401	5,679
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,081	1,343
現金及び現金同等物の期首残高	10,450	17,334
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,777	22,177

財務のポイント

●連結貸借対照表

- ・当第2四半期連結会計期間末の総資産は230,714百万円となり、前連結会計年度末比28,319百万円増加。
- ・その主な要因は、流動資産では現金及び預金が4,843百万円増加、受取手形及び売掛金が1,119百万円増加、電子記録債権が3,021百万円増加、棚卸資産が2,083百万円増加、流動資産のその他が2,255百万円増加、固定資産では有形固定資産が14,766百万円増加。
- ・当第2四半期連結会計期間末の負債は132,719百万円となり、前連結会計年度末比14,800百万円増加。

- ・その主な要因は、流動負債では支払手形及び買掛金が6,824百万円増加、短期借入金が増加が5,417百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が増加が1,374百万円増加、固定負債では長期借入金が増加が783百万円増加が主な要因。
- ・当第2四半期連結会計期間末の純資産は97,994百万円となり、前連結会計年度末比13,519百万円増加。
- ・その主な要因は利益剰余金が増加が4,345百万円増加、為替換算調整勘定が増加が9,104百万円増加。



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年3月期上期の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

2024年3月期上期連結実績

(単位：億円)

	2023年3月期 上期実績	2024年3月期 上期実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	817	862	45	5.5%
営業利益	46 5.7%	42 4.9%	-4	-9.6%
経常利益	87 10.7%	68 7.8%	-19	-22.7%
当期純利益	64 7.9%	52 6.0%	-12	-18.6%
期中平均為替レート (JPY/USD)	135.31	142.61		
1株当たり配当金	27円	27円		

2024年3月期上期商品別実績

(単位：億円)

	2023年3月期上期実績						2024年3月期上期実績					
	基板事業		EMS事業		合計		基板事業		EMS事業		合計	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	417	28 6.7%	13	0 0.0%	430	28 6.5%	452	28 6.2%	20	1 5.0%	472	29 6.1%
スマートフォン タブレット	142	7 4.9%			142	7 4.9%	115	4 3.5%			115	4 3.5%
半導体パッケージ	2	0 0.0%			2	0 0.0%	2	-4 -200.0%			2	-4 -200.0%
SSD	48	7 14.6%			48	7 14.6%	36	4 11.1%			36	4 11.1%
IoTモジュール												
AI家電・アミューズメント 医療機器	136	3 2.2%	59	1 1.7%	195	4 2.1%	109	6 5.5%	128	3 2.3%	237	9 3.8%
合計	745	45 6.0%	72	1 1.4%	817	46 5.7%	714	38 5.3%	148	4 2.7%	862	42 4.9%

2024年3月期下期・通期連結予想

(単位：億円)

	2024年3月期			予想修正差異	
	下期予想	通期予想	期初予想	増減額	増減率
売上高	868	1,730	1,650	80	4.8%
営業利益	58 6.7%	100 5.8%	90 5.5%	10	11.1%
経常利益	48 5.5%	116 6.7%	80 4.8%	36	45.0%
当期純利益	41 4.7%	93 5.4%	62 3.8%	31	50.0%
期中平均為替レート (JPY/USD)	135	138.80	130		
1株当たり配当金	28円	55円	50円		

2024年3月期下期・通期商品別予想

(単位：億円)

	2024年3月期下期予想						2024年3月期通期予想					
	基板事業		EMS事業		合計		基板事業		EMS事業		合計	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	455	35 7.7%	33	1 3.0%	488	36 7.4%	907	63 6.9%	53	2 3.8%	960	65 6.8%
スマートフォン タブレット	130	14 10.8%			130	14 10.8%	245	18 7.3%			245	18 7.3%
半導体パッケージ	2	-6 -300.0%			2	-6 -300.0%	4	-10 -250.0%			4	-10 -250.0%
SSD	51	4 7.8%			51	4 7.8%	87	8 9.2%			87	8 9.2%
IoTモジュール												
AI家電・アミューズメント 医療機器	86	6 7.0%	111	4 3.6%	197	10 5.1%	195	12 6.2%	239	7 2.9%	434	19 4.4%
合計	724	53 7.3%	144	5 3.5%	868	58 6.7%	1,438	91 6.3%	292	9 3.1%	1,730	100 5.8%

2024年3月期上期業績について

当第2四半期連結累計期間における電子部品業界は、部品不足によるサプライチェーンの混乱が収束に向かいグローバルな自動車生産台数は回復が見られるものの、世界的なインフレの継続や中国経済の減速等により消費市場は依然低迷しており、需要の回復に至りませんでした。また、地政学リスクの高まりに伴い、先行きの不透明感は強まっております。

このような状況の中当社グループでは、車載向け基板の受注が増加へ転じ、販売面でも堅調さを維持しました。スマートフォン向け基板ではハイエンドモデル向け案件やフレキシブル基板の受注が増加し、販売面でも底打ちの兆しが見えました。EMSは受託開発案件が堅調に推移しました。生産面では受注拡大に伴い工場稼働率が回復するとともに、コスト削減、投資抑制などの施策、為替の影響等も相まって、営業利益は増加傾向にありますが、新工場の稼働費用等もあり前年同期を下回る結果となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、862億円(前年同期比5.5%増)と前年同期に比べ45億円の増収となりました。損益面では、営業利益が42億円(同9.6%減)、経常利益が68億円(同22.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益が52億円(同18.6%減)となりました。

通期の見通しについて

通期の業績見通しは、当初予想においては、前年比で減収減益を見込んでおりましたが、直近の事業環境が改善傾向にあることから業績予想を修正することといたしました。

販売面は基板事業では、車載向け基板が自動車生産の回復が本格的に寄与することを見込んでいることに加えて、欧米系xEV案件が立ち上がることを想定し、期初予想の815億円から92億円(当初予想比11.3%)増収の907億円といたしました。スマートフォン向け基板は、ハイエンドスマートフォン等の受注により期初予想211億円から34億円増収(同16.1%)の245億円といたしました。SSD・IoTモジュール向け基板では、IoTモジュール基板の販売が拡大する見込みですが、SSD市況の低迷により期初予想89億円から2億円減収(同2.2%)の87億円といたしました。仕様別の売上ではフレキシブル基板の売上が拡大する見通しとなっております。EMS事業は車載向け案件が拡大する見通しですが、家電向けやHDD向け案件の需要が低迷しており期初予想313億円から21億円減収(同6.7%)の292億円といたしました。利益面では、受注拡大とともに工場の稼働率が向上しており、コスト削減や生産性改善と相まって増益を見込んでおります。

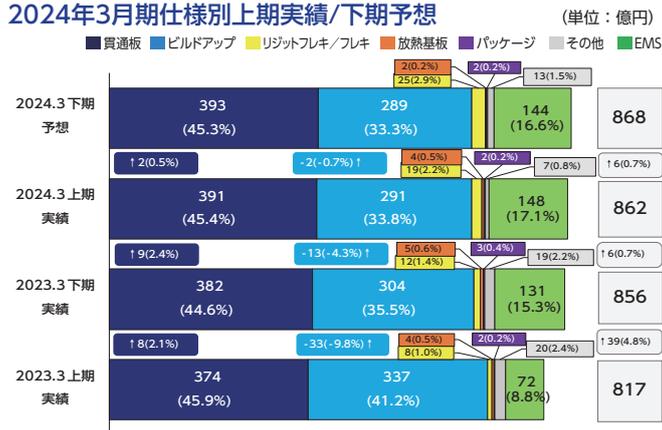
以上のことから、期初の予想に比べ売上高は80億円(同4.8%)の増収の1,730億円、営業利益は10億円(同11.1%)増益の100億円、経常利益は36億円(同45.0%)増益の116億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、31億円(同50.0%)増益の93億円といたしました。

売上高・営業利益推移

売上高は2022年3月期下期に大きく売上を伸ばし、818億円を計上しました。これ以降徐々に売上高を高めていますが、この間の需要動向は、2022年にウクライナ紛争に端を発した資源価格の高騰、コロナ禍による世界経済の大幅な需要低迷が生じました。これにより、基板事業の販売が横ばいとなる一方、EMS事業はM&Aなどもあり売上拡大に寄与しました。一方営業利益は、2022年3月期下期に77億円、営業利益率9.4%を記録しましたが、それ以降は販売の伸びの鈍化に伴い、工場の稼働率が低迷したことにより5%前後で推移しました。今期上期は、徐々に需要回復傾向となり、工場稼働率が向上しつつあります。下期はさらに回復基調となり、営業利益率は6.7%に回復すると予想しております。

今後は徐々に新工場の稼働が開始されるため、車載向け基板と半導体パッケージ基板の拡販に努め、更なる営業利益率の向上を進めてまいります。

2024年3月期仕様別上期実績/下期予想



売上高・営業利益他推移



新事業の進捗について

■天童工場の状況

天童工場は、車載向け基板を中心とした工場として建設いたしました。2023年10月に竣工し、現在はお客様の認定を進めており、2024年4月に生産を開始する予定です。天童工場は当社で初めてのエコスマート工場として設計しており、生産の自動化や、既存工場と比べ30%省エネを実現いたしました。

■石巻第2工場の状況

石巻第2工場は、SAP工法によるFC-BGA基板を生産する工場です。お客様の認定を受け生産を始める準備ができていますが、直近の半導体需要の低迷を受け約1年ほど生産が後ろ倒しとなり2024年10月に量産を開始する予定となっています。

■ベトナム第3工場の状況

ベトナム第3工場は、MSAP工法によるメモリパッケージ基板を生産する工場です。お客様の認定を受け生産を始める準備ができていますが、直近の半導体需要の低迷を受け約1年ほど生産が後ろ倒しとなり2024年4月に量産を開始する予定となっています。



株主還元について

当社は、株主の皆様に対する利益向上を経営の重点課題の一つとしております。当面は、企業規模拡大のための投資を優先し、売上と利益額の拡大に注力いたします。配当性向の目安を15%とし、利益額の拡大とともに配当額の増加を図ってまいります。

配当金

2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期(予想)
45円	55円	55円
第2四半期末 20円 期末 25円	第2四半期末 27円 期末 28円	第2四半期末 27円 期末(予想) 28円

株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待にお応えするべく、改善のための各々の施策に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



監査役
江尻 琴美

2022年6月の株主総会で選任いただき、社外監査役として職務を遂行させていただいております。2023年10月には、自動化・省人化を追求した最先端スマート工場である天童工場の竣工に立ち会い、当社が、今後一層、基板業界を牽引する立場にあると痛感しております。

そのような重責ある当社において、独立社外監査役として、監査を通じ、また充実した取締役会の運営を通じ、コーポレート・ガバナンスの確立、コンプライアンス意識の醸成・徹底、バランスのとれた持続的な成長等を図り、株主を始めとするステークホルダーの皆様へ「メイコーに関与して良かった」と心から思っただけの会社になるよう微力ながら尽力して参ります。

今後も、目まぐるしく事業環境が変化するものと推測されますが、引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

コーポレートデータ (2023年9月30日現在)

会社概要	
商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	12,004名(連結) (国内1,305名・海外10,699名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

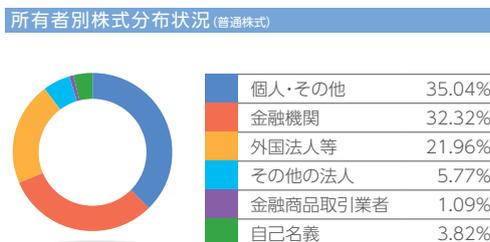
役員	
代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	名屋 政邦
取締役専務執行役員	和崎 純也
取締役専務執行役員	坂手 敦也
取締役常務執行役員	桔 梗 芳人
取締役執行役員	名屋 茂浩
取締役執行役員	申 允 生
取締役執行役員	土屋 奈生
取締役執行役員	西山 洋介
取締役執行役員	原田 隆文
取締役執行役員	小林 俊文
常勤監査役	小松 田 孝広
監査役	宮内 弘美
監査役	江尻 琴美

関連会社	
株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
メイコーエンベデッドプロダクツ株式会社	電子関連事業
メイコーエンベデッドテクノロジー株式会社	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
広州市斯皮德貿易有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Towada Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業

株式情報		
発行可能株式総数	普通株式	70,000,000株
	第一回社債型種類株式	100株
発行済株式の総数	普通株式	25,780,069株 (自己株式 1,023,251株を除く)
	第一回社債型種類株式	70株
株主数	普通株式	4,334名
	第一回社債型種類株式	1名

大株主		
株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,704	18.25
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4,033	15.65
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,553	9.91
CLEARSTREAM BANKING S.A.	945	3.67
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC /FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	635	2.46
名幸興産株式会社	608	2.36
有限会社ユーホー	521	2.02
名屋 精一	405	1.57
株式会社三井住友銀行	377	1.46
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	293	1.14

※当社は、自己株式1,023,251株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。



株主メモ	
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。



本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15 ホームページ <https://www.meiko-elec.com/>
TEL: 0467 (76) 6001 (大代表)

見直しに関する注意事項
本報告書に記載されている情報につきましては、当社の計画、業績など将来の見直しに関する記述が含まれており、これらの記述は、その時点で入手可能な情報および当社が合理的であると判断する一定の前提条件に基づいています。実際の業績は、さまざまな要素により、これらと異なる結果となり得ることをご承知おきください。



この冊子は環境保全のため、植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。